

# TECA 電子連接產業升級研討會

## 【高效能電子散熱：從液冷模擬到 AI 伺服器應用】

主辦單位：TECA 台灣電子連接產業協會

地點：工研院中興院區  
(新竹縣竹東鎮中興路四段195號)

時間：2026年6月23日(二)



### 大綱

- ◆ 液冷熱模擬技術及應用
- ◆ 熱介面材料技術與發展
- ◆ AI 伺服器液冷散熱趨勢及技術發展

### 講師

- 林健文** (現職：技術經理 / 某科技公司，  
專長：CFD熱流模擬分析)
- 朱旭山** (現職：工研院材化所正研究員，  
專長：導熱材料及散熱模組)
- 劉君愷** (現職：博士 / 某科技公司，  
專長：電子散熱結構設計)

### 適合聽課對象

適合伺服器及 3C 電子產業之理工背景學員。

### 預期效益

本課程內容涵蓋 AI 伺服器及 3C 電子產業散熱相關技術人員常見的模擬軟體能力與應用介紹、熱介面材料與應用發展趨勢、AI 液冷散熱趨勢及技術發展，透過液冷模擬設計、介面熱傳材料、液冷散熱技術的導入，可讓學員具備電子散熱的基礎能力，理解常見的散熱技術，導入現實散熱應用以解決問題、突破思維，為電子散熱領域注入新活水。

時間	課程內容	講師
09:00-10:50	液冷熱模擬技術及應用	林健文 經理
11:00-12:00	熱介面材料技術與發展(1)	朱旭山 博士
12:00-13:00	午餐時間	
13:00-14:00	熱介面材料技術與發展(2)	朱旭山 博士
14:20-16:20	AI 伺服器液冷散熱趨勢及技術發展	劉君愷 博士

費用 《AI 聯盟會員免費2名》  
會員 NTS3,800 元/人；非會員 NTS7,500 元/人

第2位以上報名→半價 (請課程五日前完成匯款始算報名並享優惠)

- 註：1. 欲取消報名需於課程5日前告知，逾時或當日未到課者，恕不退費亦不接受變更其他節課用；  
2. 課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費，於課程結束後統一退費作業！

參加辦法 請先 **傳真報名** 或 **線上報名** 並來電確認

匯款或轉帳：土地銀行 005 工研院分行 帳號 156001000292  
戶名 社團法人台灣電子連接產業協會

聯絡電話：| (03) 5910002 林小姐、5910003 朱小姐 傳真：| (03) 5910009

因颱風...等天災，新竹縣或新竹市政府，宣布停止上班，則當日課程另擇期舉行。

◎ 台灣電子連接產業協會研討會 報名表 ◎

公司全銜	(發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同公司名稱 <input type="checkbox"/> 其他)				
聯絡地址		統一編號		傳真	
E-mail		聯絡人		電話	
參加者姓名	職稱/工作部門	手機	mail	午餐	
				<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷	
				<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷	
費用共計新台幣	元整	支付方式 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯款/轉帳 <input type="checkbox"/> 現場繳費(酌收5%作業費)			

註：學員之手機號碼僅做為開課未到聯繫用

(表格如不敷使用請自行影印) 1150623 電子散熱